

为新一代的移动出行带来变革！SEKISUI解决方案

Sekisui Mobility Solution



安全 (ADAS)



环境



设计/舒适

产品咨询

积水化学工业株式会社 高机能塑料事业领域 移动出行战略室



sekisui-auto@sekisui.com



间隙形成&粘合

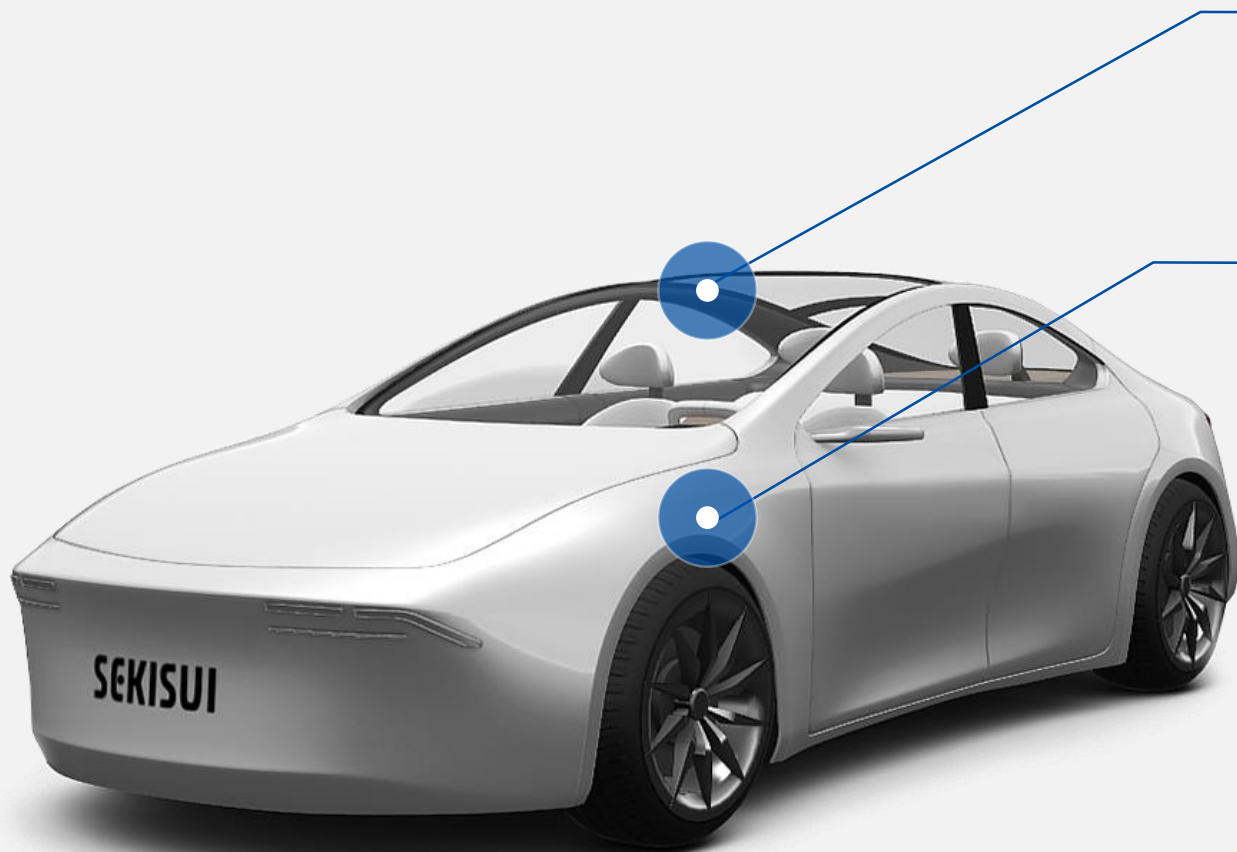
Epowell GP系列 - 功能性微粒子

安全 (ADAS)

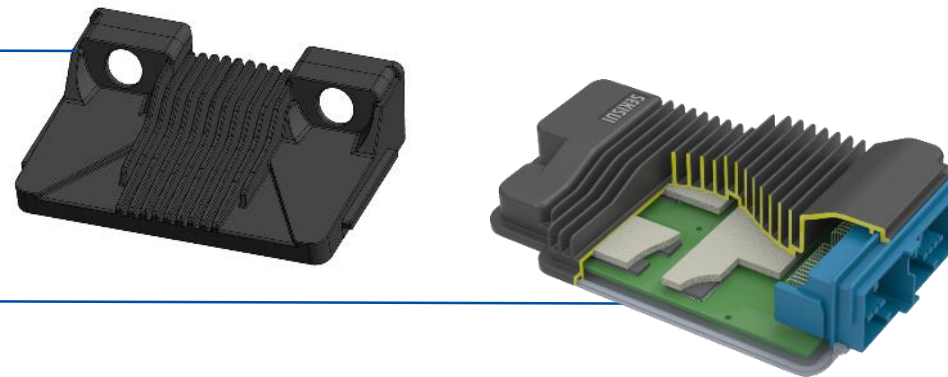
环境

设计/舒适

含有高精度微粒子的热固化型粘合剂

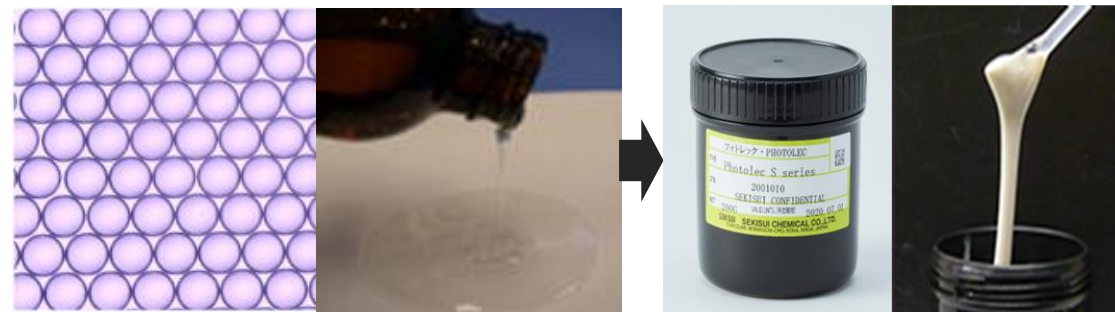


用途示例：ADAS零部件的固定



※示例图

产品



SEKISUI

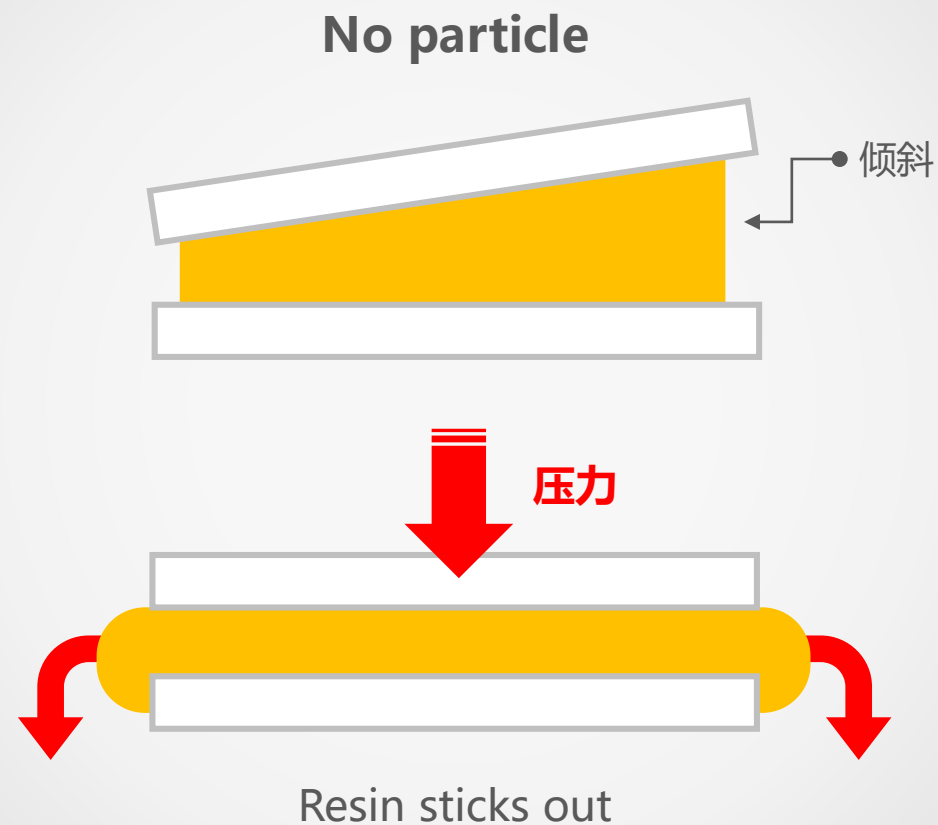
SEKISUI CHEMICAL Group



Challenge

因基板小型化、薄型化导致实装难度增大

随着封装、PCB的高性能化、小型化、薄型化的发展，实现高速化的低间隙化、保证高可靠性的间隙均一性、基板翘曲的应对、耐高温高湿等，对实装时的技术要求也越来越高。





Solution

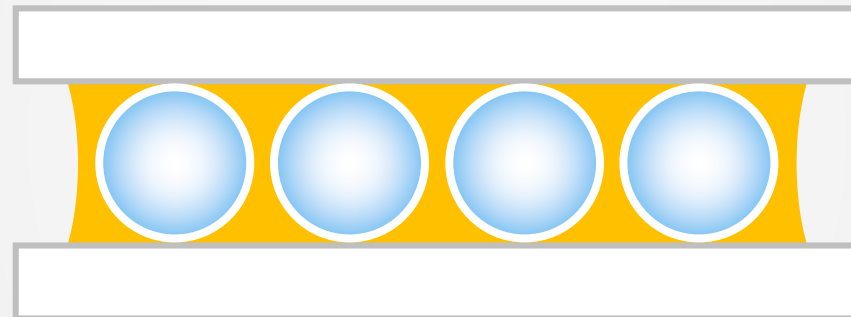
通过均一粒子保持间隙和高粘合性

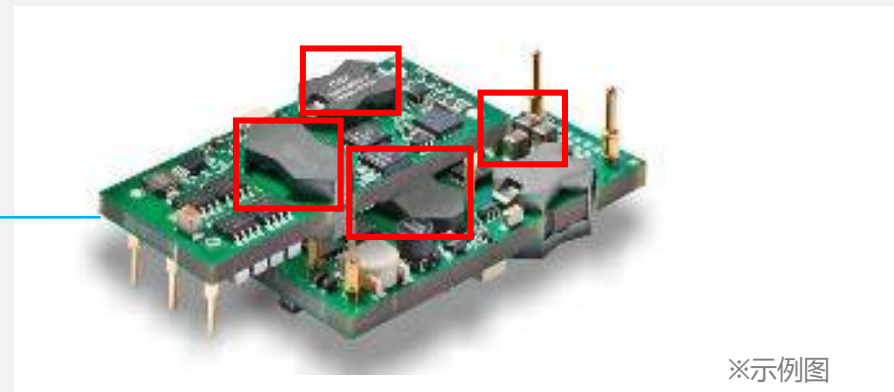
“Epowell GP系列”是含有超高精度间隔物的热固化型粘合剂。

均匀的间隙控制有助于提高间隙保持度和粘合性的均一化。

支持高温环境，在高温高湿环境下也能发挥稳定的粘合力。

粒径 $15\mu\text{m}$ - $500\mu\text{m}$ ，产品阵容丰富，可实现精密的间隙控制。





技术概述

feature

01

保持均一的GAP

- 均一的厚度控制
- 大粒子少



feature

02

丰富的产品阵容

- 15 μ m-500 μ
- 拥有丰富的产品阵容



feature

03

高可靠性

- 能够承受高温环境
- 即使在高温高湿环境下也能发挥稳定的粘合力

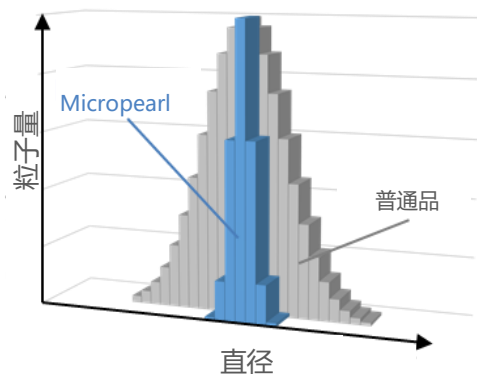




技术数据

feature

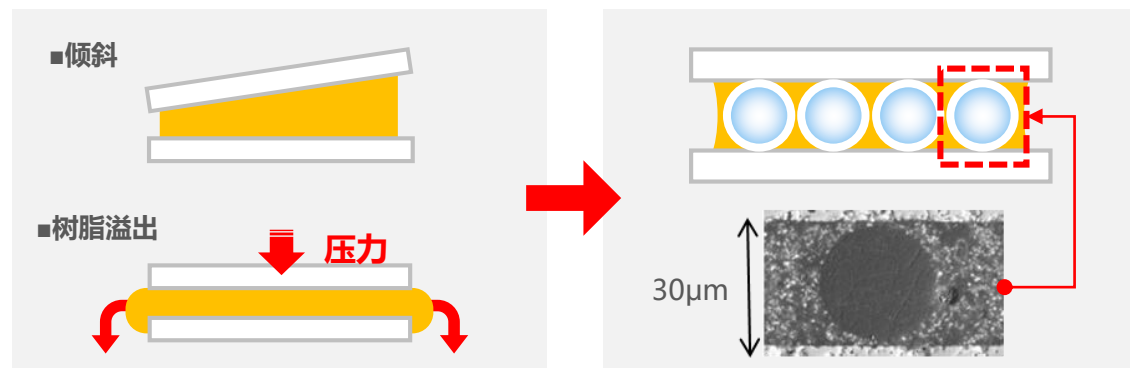
01 保持均一的GAP



- 均一的粒子分布
- 损坏GAP性的粗大粒子少

无微粒子

有微粒子



feature

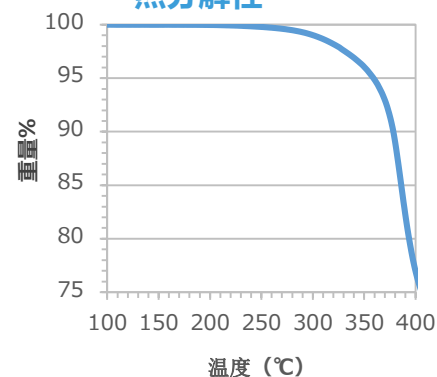
02 丰富的产品阵容

	平均粒径 [μm]	Cv [%]	等级	平均粒径 [μm]	Cv [%]
SP-215	15 ± 0.1	5%	GS-L120	120 ± 6	7%
SP-220	20 ± 0.15		GS-L150	150 ± 7	
SP-225	25 ± 0.2		GS-L200	200 ± 10	
SP-240	40 ± 0.3		GS-L300	300 ± 15	
SP-250	50 ± 0.5		GS-L350	350 ± 17.5	
GS-260	60 ± 3.0	7%	GS-L400	400 ± 20	
GS-280	80 ± 4.0		GS-L450	450 ± 22.5	
GS-L100	100 ± 5.0		GS-L475	475 ± 22.5	

feature

03 高可靠性

热分解性



耐湿热稳定性

